

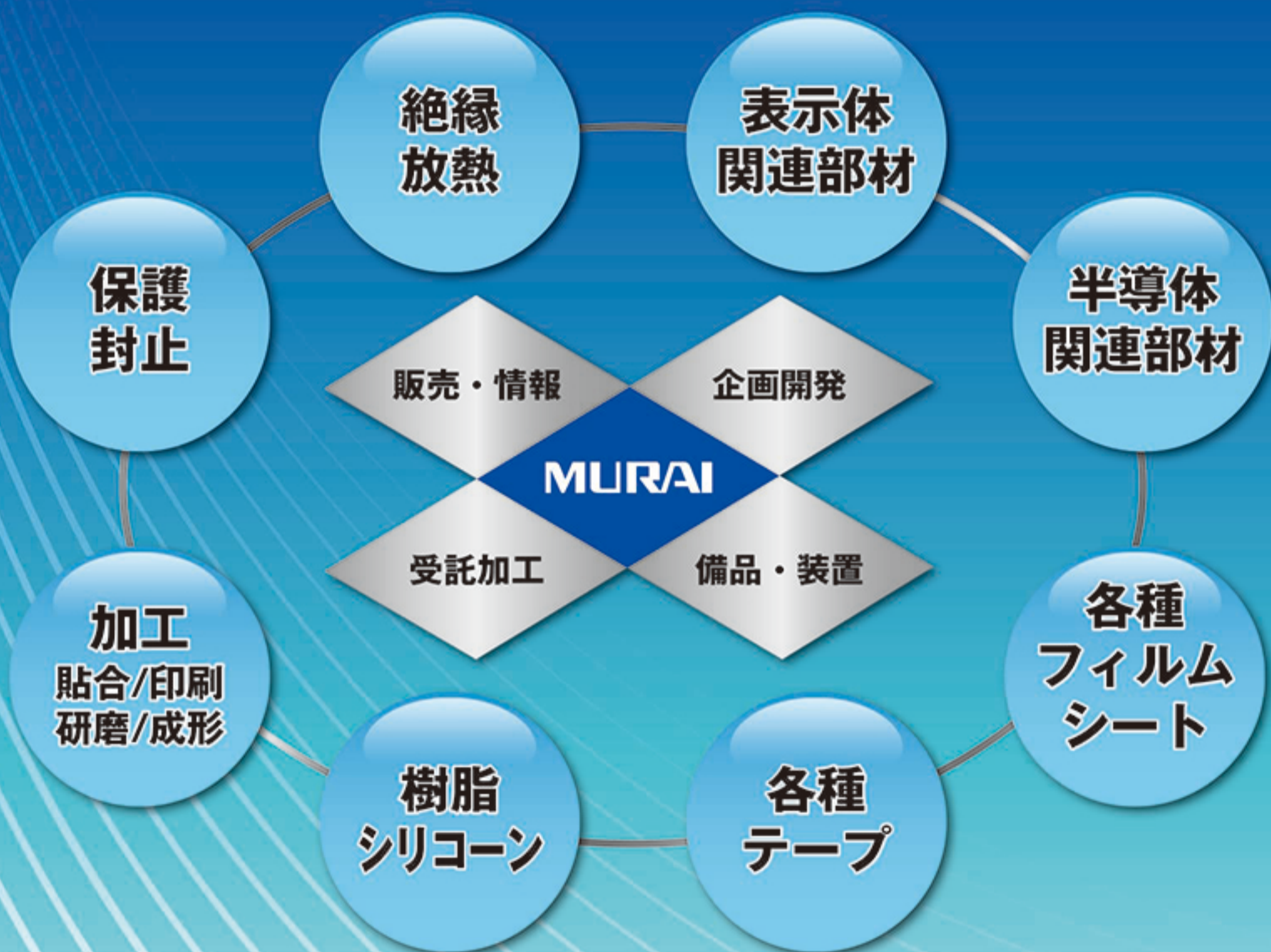
高機能素材ワールド 2016 内

第5回 高機能プラスチック展

通称: プラスチック ジャパン

村井電気株式会社

MURAI DENKI CO., LTD.



取扱製品

•ディスプレイ
光学フィルム、透明樹脂材料

•半導体
封止剤、各種テープ、搬送システム

•工業系
テープ、接着剤、副資材

•その他
各種装置、加工品、成型品

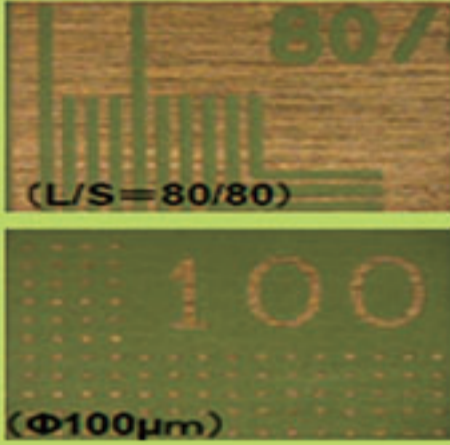
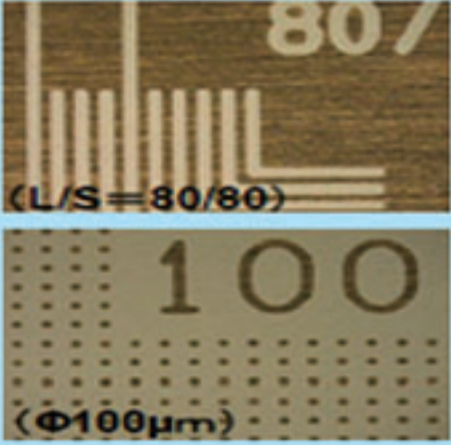
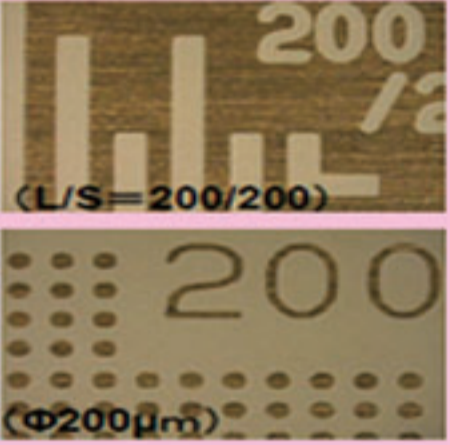
MURAI
村井電気株式会社

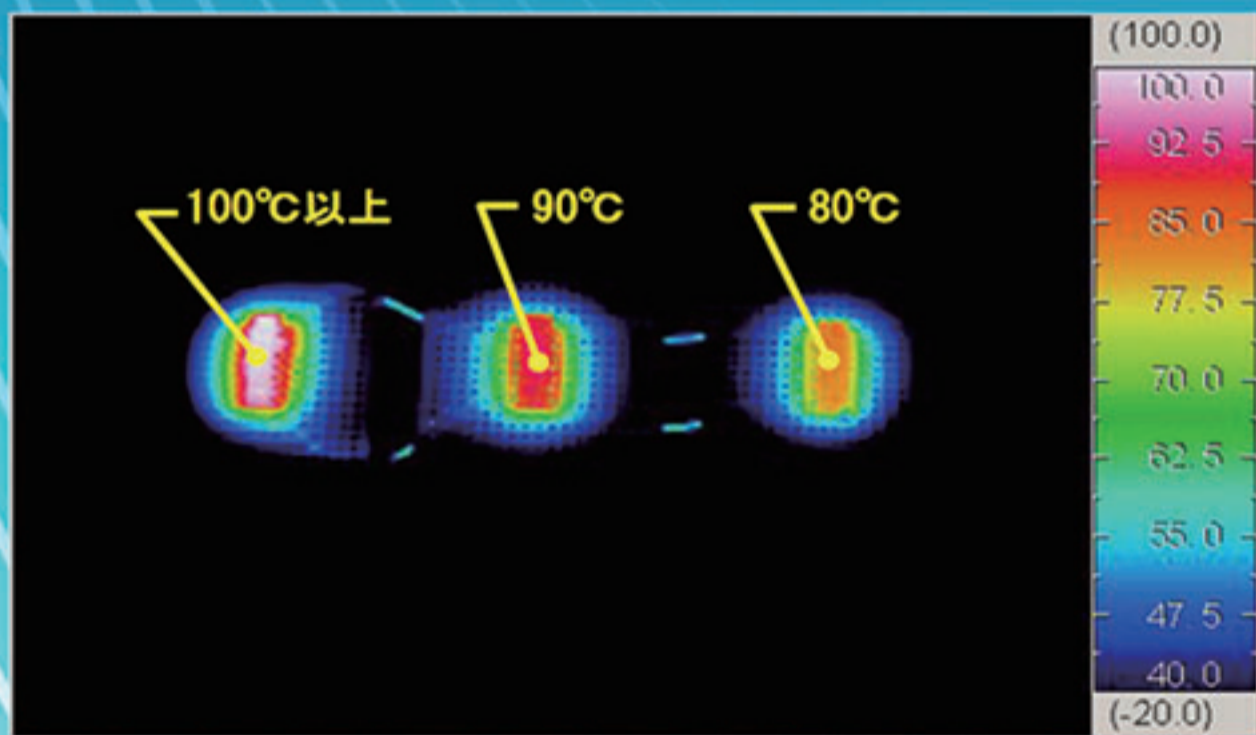
問合せ先:
村井電気株式会社 市場開発プロジェクト
TEL: 03-3255-4181
HP: <http://www.muraidenki.co.jp/> (HPよりお問合せ下さい)

高熱伝導レジスト

製造元: 太陽インキ製造株式会社 / 製品名: PSR-4000HSシリーズ

新しい熱対策のかたち

| | 一般SR | 1W 級 | 2W 級 |
|----------------------|--|--|--|
| 製品 (露光量) | PSR-4000 Gシリーズ (300mJ/cm ²) | PSR-4000HS1W (150mJ/cm ²) | PSR-4000HS2W (200mJ/cm ²) |
| 熱伝導率 (レーザーフラッシュ法) | 0.2 W/m・K | 1 W/m・K | 2 W/m・K |
| 解像性 |  (L/S=80/80) (Φ100µm) |  (L/S=80/80) (Φ100µm) |  (L/S=200/200) (Φ200µm) |



熱源: DIP抵抗 1kΩ15V印加 (5.4W)

非熱対策の抵抗器
表面温度: 100°C超
対策後



熱低減効果
20°C超

用途提案

- セラミック基板/金属基板の代替え
- 各種放熱絶縁材

本パネルの写真/データは、太陽インキ製造(株)様からの提供

保護コート材料

製造元:太陽インキ製造株式会社

永久絶縁インキ

次世代技術に向けた絶縁膜

- **低誘電**
 ϵ :3.0 (高誘電 ϵ 20.0も可能)
- **低CTE**
耐クラック性に優れたコート剤
- **硫化防止**
透明性に優れたオーバーコート剤

用途提案

- 高誘電: 高周波部品の絶縁膜
- 低CTE: 非樹脂系やプリントブルエレクトロニクス of 絶縁膜
- オーバーコート剤: 導電ペーストの硫化防止

エッチング用インキ

強酸からワークを守ります

- **耐フッ酸性**
優れた強酸耐性
- **アルカリ現像型**
高解像度



用途提案

- フッ酸や硝酸等の強酸を用いたエッチング工程のワーク保護
- ALやSUSや銅のエッチング工程のワーク保護
- サンドブラスト工程におけるワーク保護

本パネルの写真/データは、太陽インキ製造(株)様からの提供



液状粘接着樹脂

接着剤・粘着剤 困ってませんか!?

解決します

『透明』『柔軟』『密着』

『硬化収縮』『硬化温度』『ブロッキング』

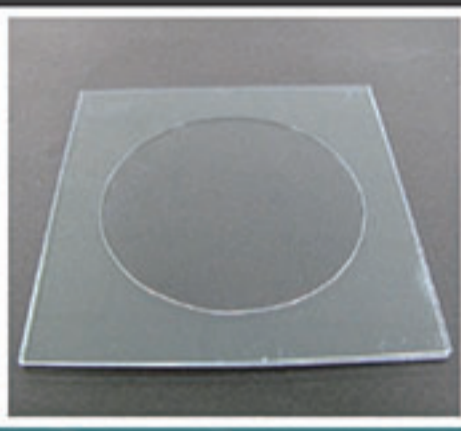
『バリア性』『耐薬品性』

硬化形態

UV/熱、熱、UV

製品群

- 透明光硬化型粘着剤
- 低温硬化接着剤
- ホットメルト型接着剤



用途提案

- タッチパネル/ディスプレイに用いる粘着及び接着剤
- 電子部品の粘着及び接着剤
- 金属や樹脂等の異素材の粘着及び接着剤
- 各種コーティングやポッティング用樹脂



UV硬化型保護樹脂

容易に剥離!!

印刷出来る保護材料

特徴

- 選択的な保護膜形成が可能
- 『高透明』『柔軟』『強靱』な皮膜

工程



基材

無機材料 (例)

ガラス、ITO、アルミ、SUS、銅、シリコンウェハ

有機材料 (例)

PET、ポリイミド、ナイロン、PP、PE、アクリル樹脂

用途提案

- ディ스플레이/タッチパネル製造工程及び出荷時のガラス/ITOの保護膜
- 半導体及び類似する市場の各工程における保護膜や仮固定膜
- 金属や樹脂の選択的な保護膜として

PTFEマイクロパウダー

エラストマー

熱可塑性
樹脂

樹脂改質剤

PTFE
マイクロパウダー

インク

塗料

**多品種少LOT
カスタマイズ対応**

承ります

ブロッキング防止

滑り性・摩擦の軽減

金型離型性向上

用途事例

- インキや塗料への添加剤
- 成型樹脂への添加剤

ガラス超精密研磨加工

協力先:株式会社ニットー

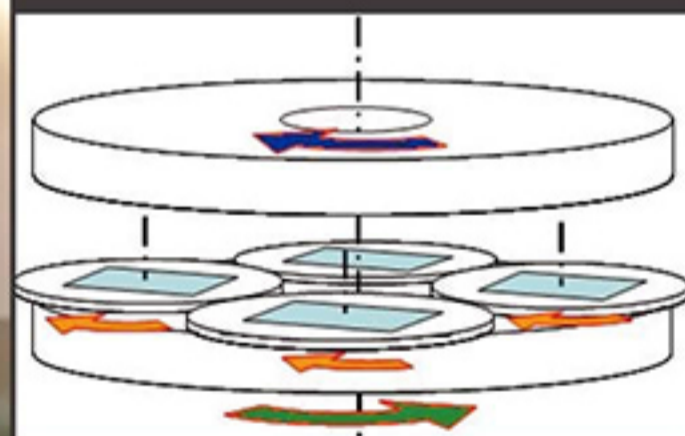
もっと薄く...
もっと平らに... 承ります

精 度

平面度: $1\mu\text{m}$ 以下 平行度: $1\mu\text{m}$ 以下 表面粗さ: 1\AA 以下



両面研磨加工



基 材 (例)

ソーダライムガラス、石英、耐熱ガラス、低熱膨張ガラス
光学ガラス、低Tg光学ガラス、無アルカリガラス、アルミナ
SiC、ジルコニア、サファイア、タンタル酸リチウム、
ニオブ酸リチウム、酸化マグネシウム、アクリル、PPS
エポキシ樹脂、ポリカーボネイト etc

参考出展

離型フィルム

特徴

耐熱性

非粘着性

機械的強度

耐薬品性

耐水性

電気特性

特性例 半導体封止工程用離型フィルム

| 項目 | 特性 |
|---------|------------|
| 厚み (μm) | 50μm、100μm |
| 幅 (mm) | 500mmW |
| 長さ (M) | 100M以上 |

カスタマイズ可能

用途例

- 半導体
金型離型 (コンプレッション、トランスファ)
- ディ스플레이
ACF圧着、ワイヤーハーネス結束
- その他
ヒートシール、搬送ベルト